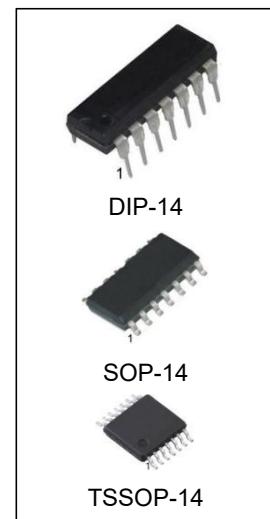


四异或门

简要说明

CD4070B 包括四个相互独立的异或门电路，具有异或功能。

CD4070B 提供了 14 PIN 塑料双列直插 (DIP) 和塑料双列 (SOP、TSSOP) 2 种封装形式。



产品订购信息

产品名称	封装	打印名称	包装	包装数量
CD4070BE/ CD4070BN	DIP-14	CD4070B	管装	1000 只/盒
CD4070BM/TR	SOP-14	CD4070B	编带	2500 只/盘
CD4070BMT/TR	TSSOP-14	CD4070B	编带	2500 只/盘

极限参数

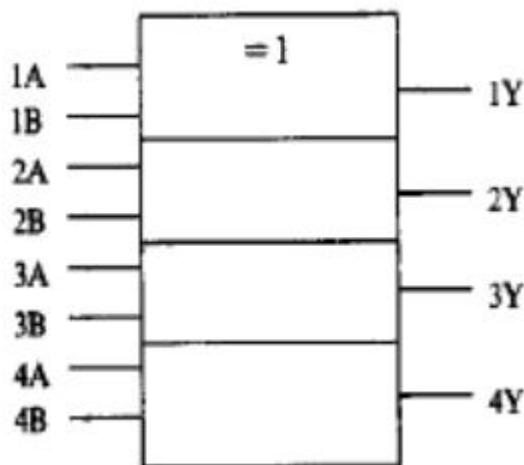
项目	最小值	最大值	单位
电源电压	5	15	V
输入电压	5~V _{DD}	+0.5	V
输入电流	-10	+10	mA
储存温度	-65	+150	°C
引脚温度 (焊接 10s)	-	260	°C

注：极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值，将有可能造成产品劣化等物理性损伤；同时在接近极限参数下，不能保证芯片可以正常工作。

推荐工作条件

项目	最小值	最大值	符号
电源电压范围	5	15	V
输入电压范围	0	V _{DD}	V
工作温度	-40	+85	°C

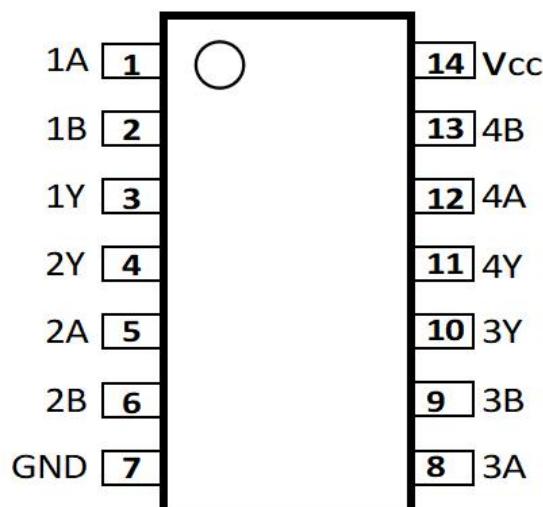
逻辑符号



逻辑表达式

$$Y = A \bar{B} + \bar{A} B$$

引出端排列（俯视）



DIP-14/SOP-14/TSSOP-14

引出端符号

符号	功能
1A~4A	数据输入端
1B~4B	数据输入端
V _{DD}	正电源
V _{SS}	地
1Y~4Y	数据输出端

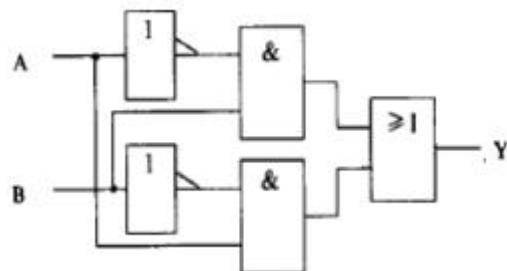
静态特性

参数	测试条件			规范值			单位
	V_o (V)	V_i (V)	V_{DD} (V)	-40°C	25°C	85°C	
V_{OL} 输出低电平电压 (最大)	-	5/0 10/0 15/0	5.0 10.0 15.0	0.05			V
V_{OH} 输出高电平电压 (最小)	-	5/0 10/0 15/0	5.0 10.0 15.0	4.95 9.95 14.95			V
V_{IL} 输入低电平电压 (最大)	0.5/4.5 1.0/9.0 1.5/13.5	-	5.0 10.0 15.0	1.5 3.0 4.0			V
V_{IH} 输入高电平电压 (最小)	4.5/0.5 9.0/1.0 13.5/1.5	-	5.0 10.0 15.0	3.5 7.0 11.0			V
I_{OH} 输出高电平电流 (最小)	2.5 4.6 9.5 13.5	5/0 5/0 10/0 15/0	5.0 5.0 10.0 15.0	-1.8 -0.61 -1.5 -4.0	-1.6 -0.51 -1.3 -3.4	-1.3 -0.42 -1.1 -2.8	mA
I_{OL} 输出低电平电流 (最小)	0.4 0.5 1.5	5/0 10/0 15/0	5.0 10.0 15.0	0.61 1.5 4.0	0.51 1.3 3.4	0.42 1.1 2.8	mA
I_i 输入电流	-	15/0	15.0	± 0.1		± 1.0	μA
I_{CC} 电源电流 (最大)	-	5/0 10/0 15/0	5.0 10.0 15.0	1.0 2.0 4.0	1.0 2.0 4.0	30.0 60.0 120.0	μA

动态特性(TA=25°C)

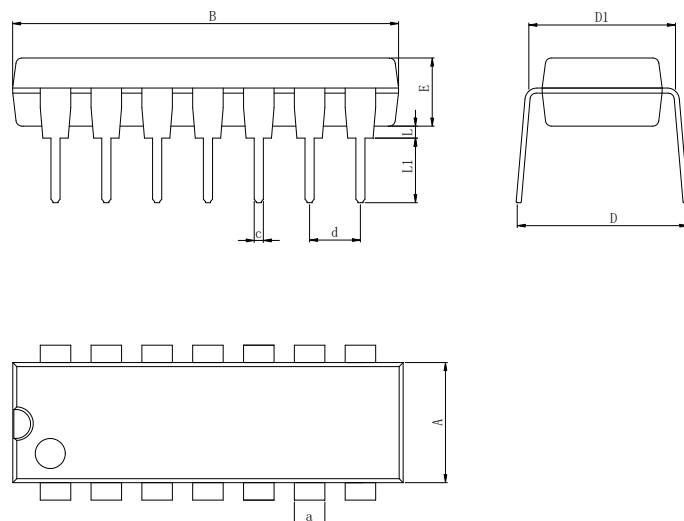
参数	测试条件	VDD (V)	规范值		单位
			最小	最大	
t_{PLH} 输出传由低电平到高电平传输延迟时间	$C_L = 50pF$	5.0		280	ns
		10.0	-	130	
		15.0		100	
	$R_L = 200k$	5.0		280	
		10.0	-	130	
		15.0		100	
	$t_r = 20ns$	5.0		200	
		10.0	-	100	
		15.0		80	
t_{THL} 输出由高电平到低电平转换时间		5.0		200	
		10.0	-	100	
		15.0		80	
C_i 输入电容 (任一输入端)		-	-	7.5	pF

逻辑图(1/4)



封装外型尺寸

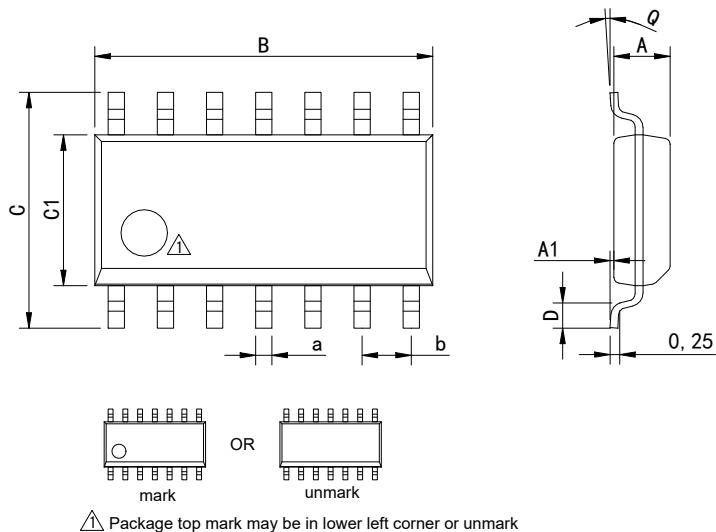
DIP-14



Dimensions In Millimeters(DIP-14)

Symbol:	A	B	D	D1	E	L	L1	a	c	d
Min:	6.10	18.94	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54 BSC
Max:	6.68	19.56	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	

SOP-14

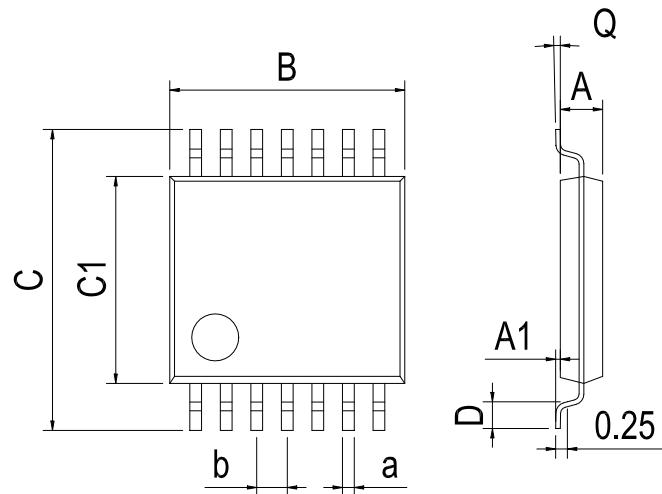


Dimensions In Millimeters(SOP-14)

Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b
Min:	1.35	0.05	8.55	5.80	3.80	0.40	0°	0.35	1.27 BSC
Max:	1.55	0.20	8.75	6.20	4.00	0.80	8°	0.45	

封装外型尺寸

TSSOP-14



Dimensions In Millimeters(TSSOP-14)										
Symbol:	A	A1	B	C	C1	D	Q	a	b	
Min:	0.85	0.05	4.90	6.20	4.30	0.40	0°	0.20		0.65 BSC
Max:	0.95	0.20	5.10	6.60	4.50	0.80	8°	0.25		

修订历史

版本编号	日期	修改内容	页码
V1.0	2014-1	新修订	1-9
V1.1	2021-11	更新封装、更新封装、更新 DIP-14 尺寸、增加极限参数注释、更新 DIP 封装新型号	1、2、6
V1.2	2024-10	更新引脚焊接温度	2
V1.3	2025-11	更新重要声明、更新 SOP-14 封装尺寸图	6、9

重要声明：

华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。

客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任：针对您的应用选择合适的华冠半导体产品；设计、验证并测试您的应用；确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。

华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠产品既不预期也不保证用于此类系统或设备，任何故障或失效都可能导致人员伤亡或严重财产损失。此类应用被视为“不安全的使用”。不安全的使用包括但不限于：手术器械、原子能控制仪器、飞机或航天器仪器、车辆使用的动力、制动或安全系统的控制或操作、交通信号仪器等所有类型的安全装置，以及旨在支持或维持生命的其他应用。华冠半导体将不承担产品在这些领域“不安全的使用”造成的后果，使用方需自行评估及承担风险，因使用方超出该产品适用领域使用所产生的一切问题和责任、损失由使用方自行承担，与华冠半导体无关，使用方不得以本协议条款向华冠半导体主张任何赔偿责任，若因使用方这种“不安全的使用”行为造成第三方向华冠半导体提出索赔，使用方应赔偿由此给华冠半导体造成的损害和责任。

华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保，测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非所有参数均需要检测。

华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示，您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，华冠半导体对此概不负责。